



## 光半導体後工程（チップ化工程）製造部長候補

### Job Information

**Hiring Company**

[Lumentum Japan, Inc.](#)

**Job ID**

1521804

**Industry**

Electronics, Semiconductor

**Company Type**

Small/Medium Company (300 employees or less) - International Company

**Non-Japanese Ratio**

(Almost) All Japanese

**Job Type**

Permanent Full-time

**Location**

Kanagawa Prefecture, Sagami-hara-shi Chuo-ku

**Salary**

12 million yen ~ 17 million yen

**Work Hours**

9:00~17:30

**Holidays**

年間休日数125日

**Refreshed**

February 24th, 2026 10:00

### General Requirements

**Minimum Experience Level**

Over 6 years

**Career Level**

Mid Career

**Minimum English Level**

Business Level

**Minimum Japanese Level**

Native

**Minimum Education Level**

Post Grad Degree (PHD/MBA etc)

**Visa Status**

Permission to work in Japan required

### Job Description

**【募集要項 本ポジションの魅力】**

- ・英語を活かせるか：英語でのメール対応・プレゼンあり
- ・働き方：日勤・土日祝休み・年間休日125日
- ・業務内容：半導体レーザーチップ生産技術部門の統括
- ・会社の特色：最先端半導体技術を支えるグローバル企業

## 仕事内容

- (1) 四半期あたりの生産量数千万チップのハイボリュームな通信用半導体レーザチップのBack-End (BE) 生産技術部門を部長レベルで管掌する。
- (2) チップ生産計画に対応したチップ選別工程設定、新品種製品開発時の新規選別工程設定。
- (3) チップ増産計画に対応したBEライン設備投資計画の策定と実行。
- (4) チップ製造ラインの歩留向上、生産能力向上 (TTR: Test Time Reduction等を含む) に向けた戦略的改善計画の策定と遂行、指揮。
- (5) 半導体工場生産高効率化に向けた有効なKPI (CT, TAKT, LT) の導入計画と実行。

## ■ポイント

メガデータセンタ (MDC)、人工知能/マシンラーニング (AI/ML) 分野でなくてはならない最先端の200Gbps等ハイスピードなInP系化合物半導体レーザチップの生産技術部門全体を部長レベルの職務で統括、管掌する。

- ・ 事業目標達成に向けてチップ生産技術部門全体組織を部長レベルで指揮、マネージメントを遂。
- ・ 半導体製造ラインのチップ増産に向けた新規設備導入と生産技術開発、各種工程設定等に関する豊富な知識と経験および製造部門のマネージメントの能力が必要。
- ・ 半導体チップ製造ラインの各工程歩留の改善、タクトタイム削減等の生産効率の改善、装置稼働率の向上、製造ライン全体の改革等に向けた戦略的長期/短期計画の策定と実行指揮を行う。

雇用形態：正社員（試用期間：3ヶ月）

想定年収：1200万～1700万円（年齢、スキル、経験を考慮の上、社内規則に伴い決定）

勤務地：神奈川県相模原市

手当・福利厚生：社会保険完備 福利厚生（通勤手当全額支給、財形貯蓄、カフェテリアプラン等有）

---

## Required Skills

### 必須の経験・能力：

半導体工場での生産技術部門、製造部門等でのオペレーションの実績、マネージメントの経験・能力が要求される。

### 歓迎する経験：

半導体光デバイスの開発または製造・生技部門でのハイレベルなマネージメントの経験があれば尚良い。

### 語学力：

英語でのメールやり取りおよびプレゼン、英語でのビジネスレビュードキュメント等の作成能力要。

---

## Company Description